

FY2023 (2024年3月期) IR デイ Q&A

>>記載の「プレゼン資料」は、[「2024年3月期 IR デイ資料」](#)をご活用ください。

2023年9月25日		
Q1	廣江社長 パート	プレゼン資料13ページについて：アウトカム（財務指標）の投資原資70%は何に対しての70%か？
A1		投資原資は、研究費控除前営業キャッシュフローで、その70%を成長投資に向けたという意味である。内部では、10年スパンの話として配当性向も含めて議論中。
Q2	廣江社長 パート	4年前に設定した経営大綱のアップデートと、今回のアップデートで大きく状況が変化した点は？
A2		メガトレンドとしては、DX、GXが加速したこと、世界経済の多極化、という2点が大きな違いだ。
Q3	廣江社長 パート	プレゼン資料13ページについて：売上高、営業キャッシュフロー比率の目標は？
A3		今中計では営業利益並みの営業キャッシュフローを生み出す構造改革を行ってきたが、まだ完全にそうなってはいない。今後10年間においても、営業キャッシュフローは営業利益の累積分と同等のレベルとなることを目標にしていく。
Q4	廣江社長 パート	プレゼン資料15ページについて：現在、構造改革領域に該当するセグメントは？
A4		現状、FTが該当。他のセグメントは、構造改革領域から既に脱出した。
Q5	廣江社長 パート	事業会社内の構造改革領域については、どう考えているか？
A5		事業会社内では、製品ごとにROICと売上高成長率の2軸を用い、どの製品が構造改革領域にあるかを判断し、社長直下で改革を図っている。この取り組みは徐々に成果が出ている。
Q6	廣江社長 パート	ソリューションクリエイターの育成に、何か具体的な社内施策はあるのか？
A6		社会課題を解決する製品、サービス、技術などを、ソリューションクリエイターと定義している。お客さまに販売する全てのものをソリューションとしたい、という思いがある。それを生み出すことを通して、育成していきたい。
Q7	廣江社長 パート	2000年代の初頭、画像情報処理機器事業（現・GA）の開発費が半導体製造装置事業より多い年があり驚いた記憶があるが、今回のポートフォリオマネジメントの下ではそういったことは起きないか？
A7		バランスのとれたマネジメントをしていく。状況の急変といった事態もあるかもしれないが、その際には全社を挙げて改善に取り組むスキームとしている。
Q8	後藤社長 パート	・プレゼン資料25ページのSPEの売上高推移はよく整理されているが、来期売上目標の「新アプリケーション」の中身、確度、タイミングについて教えて欲しい

		<p>い。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前期、今期について、工場の生産キャパシティにネックがあったとの説明があったが、来期（2025年3月期）で区切った場合、どれぐらいのキャパが上限として考えられるか？
A8		<ul style="list-style-type: none"> ・新アプリケーションの中身について具体的な話ができないが、売上確度は十分にあると思っている。 ・前期からの持ち越し分は今期でキャッチアップできる。今期から来期への持ち越し分はあるが、来期の生産キャパシティでは不足は発生しない。トップラインに関しては、今後生産性の改善などでさらにキャパシティを伸ばす余地はあり、5,000億円の売上を十分カバーできるキャパシティがあると考えている
Q9	後藤社長 パート	洗浄装置の成長性について、ここ数年 WFE をアウトパフォーム出来ていないが、その理由は何か？また、なぜ今後はアウトパフォームすると言えるのか？
A9		洗浄の重要性を顧客に充分アピールできていなかった。今後はデバイスのイールド（歩留まり）を保つためには、洗浄が肝であることをしっかり訴求していく。
Q10	後藤社長 パート	洗浄市場で SCREEN がさらに上を目指していくにあたって、今、足りていない部分は何か？
A10		マーケットシェアが下がっていることは事実であり、シェアを上げていきたい。また製品ポートフォリオでも、改善余地があると思っている。
Q11	後藤社長 パート	WFE における洗浄の TAM が（10年後に）1.5%上がることについて、考え方を教えて欲しい。
A11		1.5%増加の部分は、WFE として計算されない洗浄工程（例：実装工程）も含まれる。デバイス構造が変わってくると、今まで WFE に含まれていなかった洗浄領域が増えてくることは技術パートで説明する。
Q12	後藤社長 パート	プレゼン資料 26 ページ：洗浄工程の対 WFE 比率低下は止まるのか？
A12		そう考えている。
Q13	後藤社長 パート	プレゼン資料 31 ページの「 α 、 β 、 γ 」の意味は？
A13		微細化の進行を示している（ $\alpha \Rightarrow \beta \Rightarrow \gamma$ と微細化）。技術ノードが微細になるにつれて、実装工程での洗浄が出てくるという例示である。現在既に α から γ の世代に移行しているとお考え頂きたい。
Q14	高橋 TB パート	プレゼン資料 42 ページについて：CFET 構造への洗浄技術適用の確度はどう考えるか？（ガスエッチではなく）。
A14		CFET の構造は、SiGe の濃度が複数存在する中で高い濃度の SiGe だけ除去する必要があり、GAA より難易度が上がっている。ガスエッチも選択エッチングが可能と考えているが、エッチング後、残留したゲルマニウムを効果的に排出するにはウェット処理が必須。選択エッチと残留物の洗浄が両方ウェット洗浄で出来れば、顧客にとってメリットは大きい。
Q15	高橋 TB パート	プレゼン資料 44 ページについて：EUV 世代の先端領域で FEOL 比率が高まってくる理由は？
A15		BSPDN (Backside Power Delivery Network) などの構造では、FEOL 領域で今までにないメタル埋め込み向け構造などが増えてくると想定している。

Q16	高橋 TB パート	プレゼン資料 44 ページについて：Non EUV 世代で洗浄工程数が増えていく理由、また EUV 世代で洗浄工程数が頭打ちになる理由は？
A16		Non EUV 世代での洗浄工程増は、多くはマルチ・リソステップ（多重露光）に関係している。Non-EUV 世代では多重露光によって微細化が進んだが、EUV 世代では一度で露光するような進化があり、ステップ数の増加は鈍化すると考えている。
Q17	GA 田中社 長パート	ラベルパッケージへは既に製品を投入しているのか？競合と比べての優位性は何か？
A17		2014 年にデジタルラベル印刷を市場投入し、累計 250 台を超える出荷実績がある。パッケージ向けも、開発中の製品が間もなくリリースできる状況。インクジェット方式のフレキシビリティやスループットの高さを生かして競合に対抗していく。
Q18	FT 園田社 長パート	今後 10 年の競争環境を考えたときに、今どのような施策があるか？
A18		自社調べではあるが、マーケットシェアは 50%以上を維持している。今後も中国の家電メーカーが取り組む各種パネルの製造技術にしっかり伴走しながら、パネル製造におけるデファクトスタンダードを目指して技術を研鑽していきたい。
Q19	FT 園田社 長パート	今後更にマーケットシェアが上がると、営業利益率にどのような影響があるか？
A19		製品単体の収益性については、製品の付加価値を上げていくことが重要。またディスプレイ製造装置以外でも塗布の技術を生かして進出を図り、収益性の向上を目指していく。
Q20	FT 園田社 長パート	インクジェット OLED の将来性についてはどう考えるか？
A20		今後、お客さまとの対話の中で、進む方向を見極めていきたい。
Q21	PE 末森社 長パート	パターンング（直接描画）に関して、ガラス基板向けや光電融合、PLP (Panel Level Package) などでのビジネス機会について教えていただきたい。
A21		今後は、有機材だけでなく、ガラス、セラミックなどが露光対象物として出てくる可能性があり、順次評価を進めていきたい。PLP については、アドバンスドパッケージの（グループ内の）事業がカバーしている。
Q22	新規事業 (廣江社長 パート)	・ 10 年後に 1 兆円以上を狙う場合、彦根に追加の設備拡張スペースはあるか？ ・ BCP の観点から、他の地域で工場を持つ考えはあるか？
A22		・ 彦根にはまだ若干の拡張余地がある。 ・ 10 年後を見据えて、中計ごとに成長投資の内容を検討していく予定であり、彦根に限らず、他の土地を見つけ事業をサポートする体制を作ること、ホールディングスの使命であると考えている。今後順次ご紹介したい。
Q23	新規事業 (廣江社長 パート)	今後の R&D 投資の対売上比率はどう考えている？
A23		成長投資の中での、開発投資、設備投資の内訳は、現時点ではまだ開示していない。来期以降、新中計の中で開示していきたい。

Q24	全体 Q&A	PLP に関する盛り上がりはどう考えている？
A24		我々としては、PLP、WLP(Wafer Level Package)の両方をターゲットにしている。世間的には WLP 投資が先行しているが、PLP については新製品の LeVina も具体的なビジネスが盛り上がりつつあり、大いに期待している。
Q25	全体 Q&A	新経営大綱売上高目標の「1 兆円以上」はオーガニックグロスなのか？
A25		成長の一つの手段として M&A も含んでおり、1 兆円のうち何%かは M&A によるものを想定している。
Q26	全体 Q&A	SPE の洗浄売上に偏った製品群について、アドバンテージ、ディスアドバンテージを感じているか？
A26		洗浄に関しては今後も一定の成長を期待しているが、その他の領域についても中計で一定の予算を立て、既存、新規事業を問わず M&A は検討する。
Q27	全体 Q&A	プレゼン資料 44 ページについて：EUV で今後洗浄工程が増えない事を考えると、シェア拡大の為にメモリーへ大きく進出していくのか？
A27		そこまで強いメッセージではない。先端ロジックで培った技術を展開しながら徐々にエクスポージャーを増やしていきたい。
Q28	全体 Q&A	事業ポートフォリオについて、今の事業会社のドメインを見直すことも考えられるのか？
A28		ROIC と売上高成長率による分析により、既存事業でも見直しはありうる。ROIC のハードルレートは開示していないが、それが判断基準となる。
Q29	全体 Q&A	SPE の FLA (Flash Lamp Anneal) は注力事業との認識か？
A29		工程数も徐々に増えつつあり、今後伸ばしていきたい事業。
Q30	全体 Q&A	SPE の実装エリアで洗浄が増えるのは、どれぐらいの分量と考えるか？
A30		WFE をアウトパフォームする 1.5%分は実装エリアからと考える。現状ではまだ多くは無いが、10 年後にはそうなると想定。
Q31	全体 Q&A	SPE のアドバンスドパッケージ領域では、既に装置固有の洗浄処理が存在しているが、その中で SCREEN の TAM はどれぐらいになるイメージか？
A31		具体的な数値は開示していないが、TAM を増やす意味では実装エリアで他の装置と洗浄に関するコラボレーションも考える余地はあるだろう。
Q32	全体 Q&A	プレゼン資料 24 ページについて：来期のマーケットシェアアップのドライバーは何か？
A32		新しいアプリケーションの成長によって、WFE の落ち込み量よりも、弊社の売上の落ち込み量は緩やかである。新しいアプリケーションについてはさまざまな内容があるが、内容を開示することでお客さまが特定される可能性があり、開示はご容赦いただきたい。
Q33	全体 Q&A	プレゼン資料 26 ページについて：実装工程における SCREEN の洗浄装置の市場シェアはどれぐらいか？
A33		現状シェアについてのコメントは難しいが、ローエンドであるボンディング、CMP 周りの洗浄が今後クリティカルになっていくことで、ビジネスを広げるチャンスがある。
Q34	全体 Q&A	SPE のマーケットシェアアップの要因について、今一度説明をお願いしたい。
A34		・微細化に伴って、新材料や新しいプロセスステップが出てきており、実際にさまざまな相談を受けている。前工程では EUV 露光のデフォーカス対策の裏面洗浄

		<p>の機会が伸びており、後工程でもクリティカル洗浄の需要も出てきた。そういった内容を総合的に合算し、我々のマーケットシェアは上がっていくと考える。</p> <ul style="list-style-type: none">・実装工程での洗浄工程が WFE にカウントされるかどうかは、今後調査会社とも意見交換し、見極めていく。
--	--	---

HD: ホールディングス、SPE: 半導体製造装置事業、GA: グラフィックアーツ機器事業、
FT: ディ스플레이製造装置および成膜装置事業、PE: プリント基板関連機器事業